

## 应用介绍

**特点** 一款单组份导电硅胶粘接剂，加热高温固化，具有较强耐高温性及稳定的高可靠性；适用于热敏感器件芯片粘接固定

**粘接材料** 金属，塑料/PCB，玻璃，陶瓷等

**典型应用** LED 芯片固晶粘接导通

## 固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	硅胶树脂	
颜色	银灰色	
粘度(cps)	10000-15000	5rpm@25°C, ASTM D-1084
比重(g/cm <sup>3</sup> )	3.2	
固化条件	3hrs@150°C 或 1hrs@180°C	
有效期@ -5°C,月	6	

## 固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	银灰色	
粘接强度 MPa	4	金属+金属
邵氏硬度 D	60	
电阻率	5*10 <sup>-5</sup> Ω.cm	IEC 60167:1964, IDT
导热系数	1.0 w/m.k	
降解温度	400°C	
可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1.5%	
工作温度范围*	-60°C—200°C	

## 储存和使用方法

产品低于-5°C冷冻环境中保存。使用前需要从冰箱拿出，30ml 室温下解冻 2 小时方可使用；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件

## 注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。



技术参数

# 8130

日期 : 01/2018

上海禧合应用材料



[www.stick1mat.com](http://www.stick1mat.com)

Email: [info@stick1mat.com](mailto:info@stick1mat.com)

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

